

混合存储器立方体联盟继续推动 HMC 行业
的采纳随着第二代规范发布

第二代规范初稿发布

加州圣荷西和爱达荷州博伊西，2014 年 2 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE) – 致力于为混合存储器立方体(HMC)技术开发和制定行业标准接口规范的混合存储器立方体联盟(HMCC)今日宣布：其将继续致力于建立 HMC 生态环境，并通过制定新的接口规范以支持本行业采用该项突破性技术。HMCC 今日还向该联盟的采纳厂商发布了该规范的第一版初稿，该联盟的成员不断增加，目前已有 120 多位。该新规范支持提高数据传输速率，使其短距传输 (SR)性能从 10 Gb/s、12.5 Gb/s 和 15 Gb/s 提高到 30 Gb/s。该新规范还将相关的通道模式从 SR 迁移至甚短距传输 (VSR)，以便与现有行业术语保持一致。超短距传输(USR)的定义也将速度性能从 10 Gb/s 提高至 15Gb/s。

HMCC 由 Micron Technology (纳斯达克股票代码：MU)、Samsung Electronics、和 SK hynix 等领先存储器供应商所创立，目前已将该规范初稿送至各采纳厂商广泛流传，以期综合各位成员的意见，并计划 2014 年 5 月完成终稿。第一代规范并于 2013 年 4 月公开发表；一些参与制定和采纳该规范的公司，包括 Altera、Xilinx、和 Open-Silicon 已开始采用该规范设计使用 HMC 技术的产品和解决方案。

“采用 HMC 第二代规范，设计师就能从我们的 UltraScale FPGA 架构中提取出更高的性能”，Xilinx 产品组合和解决方案营销副总裁 Hugh Durdan 说。“我们目前正在发运的 UltraScale 设备已设计为支持该规范，以便向高带宽用于市场提供风险更低、速度更高的产品”。

“第二代 HMC 规范使接口的数据传输速率提高一倍，这使得系统设计师能利用下一代 20 纳米和 14 纳米 FPGA 以及 SoCs 更容易地实现性能的提高”，Altera 产品营销高级总监 Patrick Dorsey 说。“我们很早就开始提供评估板，并演示证明了 HMC 设备和 FPGA 之间的互操作性，使客户立即就能开始评估和开发基于 HMC 的高性能系统”。

该联盟是由一群原始设备供应商、促进商和集成商密切合作的产物，这些厂商共同合作开发和实施关于由 Micron 开发的高性能存储器解决方案 HMC 的开放接口标准。开发商成员 Micron Technology, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Altera Corporation、ARM、IBM、Microsoft Corporation、Open-Silicon, Inc.、SK hynix, Inc.和 Xilinx, Inc.正与采纳厂商直接合作以支持创建 HMC 的新市场和行业采纳的整体需求。

本行业突破性的 HMC 采用了先进的硅穿孔(TSV)技术，其通过垂直导管将一组单独的芯片在电气性相连接，以将高性能逻辑电路与动态随机存取存储器(DRAM)模具相结合。Micron 正在提供第一款商用 HMC 产品的样品，该产品密度为 2GB，存储带宽达空前的 160 GB/s，而每比特能耗比现有技术少 70%，这大幅度地降低了客户的总拥有成本。

DRAM 的性能改进率和处理器数据消耗率之间的差距不断地增大，而 HMC 已被行业领袖和有影响人士视为解决该问题期盼已久的答案。HMC 的性能代表着其性能、封装和能效等方面远超前于当前和近期的存储器架构，与现有的存储器技术有巨大的差别。

欢迎成为 HMCC 成员

有志于参与 HMC 规范制定的任何公司均可成为 HMCC 的采纳商会员。可在 www.hybridmemorycube.org 上获取关于采用该技术的更多信息、技术支持说明以及其他工具。

关于 HMCC

混合存储器立方体联盟(HMCC)由世界半导体行业顶级成员所创立，其宗旨是为混合存储器立方技术制定和建立行业标准接口规范。该联盟成员包括 Altera、ARM、IBM、Micron Technology、Microsoft、Open-Silicon、Samsung、SK hynix 和 Xilinx。欲知关于 HMCC 的更多信息，请访问 www.hybridmemorycube.org。

联系方式: Mary Ellen Ynes

Zeno Group for Micron

+1.650.801.7954

maryellen.ynes@zenogroup.com

John Lucas

Samsung Electronics Co., Ltd.

+1.408.544.4363

j.lucas@ssi.samsung.com